

ePaste Ag添加 汎用鉛フリーソルダペースト

SN99CN P506 D4



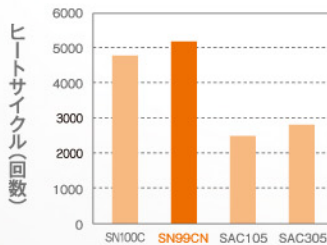
Ag添加とNi効果で、かつてない接合強度を実現

SN99CNは鉛フリーはんだ「SnCuNi」合金に微量のAgを添加することで、接合界面に安定した合金層を形成し、かつてない接合強度を実現した新合金です。

落下衝撃に強いいためポータブル機器などの基板接合に最適です。

Ag 1.1%	鉛 フリー	高強度	印刷用
耐ヒート サイクル性 良好	経時安定性 良好	チップ立ち 抑制	

耐ヒートサイクル特性 Ni添加により耐久性を向上



	あり	あり	なし	なし
Ni添加				
Ag含有	なし	1.1	1.0	3.0

はんだ合金	サイクル数
SN100C	4822
SN99CN	5197
SAC105	2518
SAC305	2880

【試験条件】
基板温度125℃/30分、-40℃/30分、サイクル数は全体の63%がオープンになるまでの回数を示す(抵抗値変化により測定)

繰返し印刷性 粘度上昇が少なく、安定した印刷性を持続

印刷形状の外観写真



【試験条件】

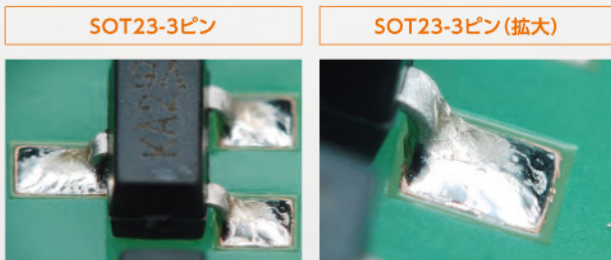
はんだ充填量: 350g
基板パターン: 0.4mmピッチQFP
メタルマスク厚: 120μm
印刷環境: 25℃ 30~50%RH
印刷速度: 30mm/sec.

【試験条件】

印刷試験を行い0時間、4時間、8時間毎に粘度を測定。4時間毎にはんだを補填し、8時間毎に容器を回収して冷蔵保存。この試験を7日間連続して実施した。

ぬれ上がり リード端面部のぬれ上がりが良好

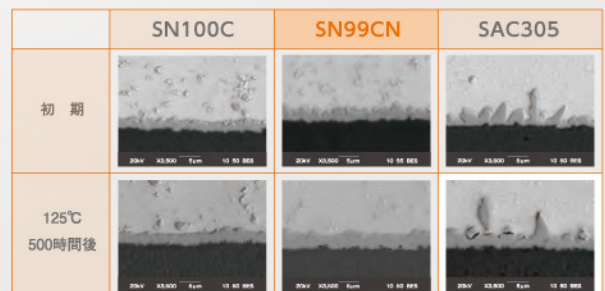
はんだ付部の外観写真



【試験条件】

印刷厚: 120μm / 昇温速度: 1.5℃/sec. ピーク温度: 240℃ / はんだ溶融時間: 50sec.

接合界面の状態 平坦な合金層((Cu,Ni)₆Sn₅)を形成



※上記データ、写真は特定条件下によるものです。